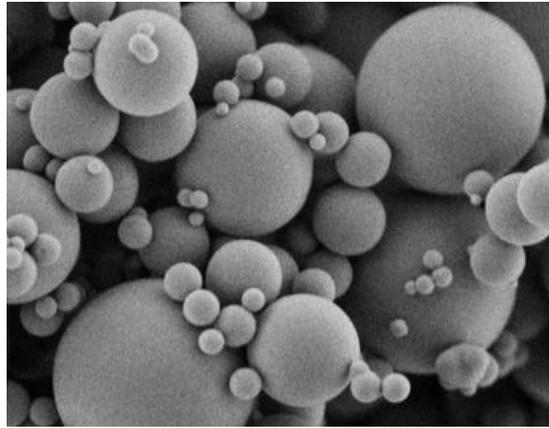


5G通信向け最先端機能性セラミックスフィラー「デンカ溶融シリカ（DF）低誘電正接タイプ」 を本格投入

～通信中の伝送損失を低減し、高速・大容量通信に寄与～



<デンカ溶融シリカ（DF）低誘電正接タイプ（拡大写真）>

デンカ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井俊夫）は、5G通信向けに伝送損失*1を低減し、高速・大容量通信の実現に欠かせない最先端機能性セラミックス「デンカ溶融シリカ（DF）低誘電正接タイプ」を10月から本格的に市場投入いたしました。本製品は今年10月27日（水）～29日（金）に東京ビッグサイトで開催される「電子機器トータルソリューション展2021（JPCA Show）」に展示いたします。

5G 移動通信ならびにミリ波帯電磁波の利用は、スマートフォンのみならず、高速・大容量である特色を生かした遠隔医療や防災、農業・製造現場の効率化など幅広い分野に導入が進み、持続可能な社会の実現に重要な役割を担っています。これに伴い、飛躍的に増加する通信の量・質の低下を最小限に留め伝送するための低伝送損失・低誘電正接の配線材料の開発が強く求められてきました。樹脂や銅箔・ガラスクロスのみならず、フィラーにおいて低伝送損失を達成するために開発されたものが本品です。

本製品は、半導体封止材向け絶縁フィラーとして国内外のユーザーから高い評価を頂いている「デンカ球状溶融シリカ（FB・SFPグレード）」をベースに、均一な球状と粒度分布はそのままに独自の表面処理改質を施すことにより、当社比で約40～50%の誘電正接低減を実現いたしました。高速・大容量の5G通信実現に寄与する材料として、主に通信用樹脂材料（樹脂基板・封止材など）向けに展開し、SDGsに掲げる産業と技術革新の基盤をつくることに貢献してまいります。

当社は1915年の創業以来培ってきた無機材料の高温焼成・窒化反応・粒径制御等の基盤技術を元に、球状溶融シリカをはじめ、窒化ケイ素、窒化ホウ素(BN)、球状アルミナ、蛍光体などの様々な機能性セラミックスを製造しており、これら製品は半導体・電子機器、風力発電、通信基地局、自動車等に幅広く使用されています。今回投入した「デンカ溶融シリカ（DF）低誘電正接タイプ」の他、昨年には高熱伝導材料「デンカ球状マグネシア」を投入しています。さらに今後は球状チタン酸バリウム等の新規

機能性セラミックスや低誘電有機絶縁材料（LDM）、LCPフィルム等の開発も進めてまいります。

当社は今後もSDGsを羅針盤に、誰よりも上手にできる仕事で全ての方がより良く生きる世界をつくる、社会にとってかけがえのない企業を目指してまいります。

以 上

*1 通信線路における、電気信号や光信号などの信号が劣化する度合い

【報道関係者からの問い合わせ先】

コーポレートコミュニケーション部（電話 03-5290-5071）

【お客様からの問い合わせ先】

電子・先端プロダクツ部門 先端機能材料部（電話 03-5290-5541）